全球半导体行业周报

服务器芯片收入增长、光互连整合与半导体股回调

发布主体：百思特变革研究院半导体智库 | 期次日期：2026-11-08 | 覆盖窗口：11 月 2 日至 8 日 | 截至北京时间 2026 年 11 月 9 日 09:15

本期总判断

服务器芯片与光互连的需求正在转化为收入和交易。 AMD 三季度数据中心收入同比增长 97%，集团四季度指引中值比本季增长约 27%。11 月 18 日英伟达财报可提供另一组交付依据。[R01、R20]

互连器件。 Marvell 于 11 月 2 日公布收购 Lumentum 协议，标的隐含企业价值为 1,150 亿美元。以消息公布前未受影响股价计算，隐含每股对价溢价 23.9%。换股比例为 4.500，预计 2028 年上半年交割。[R08、R09]

电源器件。 onsemi 同日签约收购集成稳压器厂商 Ferric，现金对价 6 亿美元，另有最高 1.75 亿美元或有付款。其 2030 年 AI 数据中心收入目标上调 5 亿美元至超过 30 亿美元。[R10]

终端差异。 AMD 游戏收入同比下降 40%。高通 QCT 汽车收入 19.90 亿美元，手机收入同比下降。节日备货与存储成本将影响后续终端出货和毛利。[R01、R03]

资本市场。 费城半导体指数收于 9,390.25 点，周跌 12.15%。科创 50 收于 1,253.19 点，周涨 7.96%。美国 10 年期国债收益率由 4.94%降至 4.86%。[R14、R16、R17]

后续观察。 11 月 10 日台积电公布 10 月营收，11 月 13 日应用材料披露季度业绩。关注先进制造收入、设备交付和客户预付款能否同步改善。[R18、R19]

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

目录

本周概览.....3
一、本周要点.....6
二、重大事件及其影响.....7
三、行业景气与资本市场.....7
四、存储周期与装备制造链.....8
五、政策、贸易与供应链安全.....9
六、重点企业动态.....9
七、中国半导体产业链.....10
八、行业会议与人物观点.....11
九、趋势判断.....11
十、主要风险与下周关注事项.....12
十一、管理观察与行动建议.....13
数据来源与口径.....13

阅读导引。企业决策层可阅读本周要点、趋势判断与管理观察。制造、存储和设备企业可结合产业景气重点企业及下周日程。

百思特管理咨询集团

本周概览

关键指标

韩国半导体出口（10 月） **564.4 亿美元** 同比 +259.4% 11 月 1 日发布，最新整月口径[RK]	费城半导体指数（11 月 6 日） **9,390.25 点** 周 −12.15% 10 月 30 日 10,688.80 点[R14、R15]	科创 50（11 月 6 日） **1,253.19 点** 周 +7.96% 交易所周报[R16]
AMD 数据中心收入 **85.46 亿美元** 同比 +97.0% 三季度，11 月 3 日披露[R01、R02]	Lumentum 隐含企业价值 **1,150 亿美元** 隐含溢价 +23.9% 11 月 2 日公告，溢价为每股口径[R08]	美国 10 年期国债收益率 **4.86%** 周 −8 bp 11 月 6 日恒定期限收益率[R17]

一周大事记

11 月 2 日
周一

- Marvell 与 Lumentum 公布全股票交易
- onsemi 披露季报及 Ferric 交易
- Tower 披露三季度结果
- Synaptics 交易修订现金对价[R06—R11]

11 月 3 日
周二

- AMD 公布三季度收入 133.77 亿美元
- SIA 公布九月全球销售数据
- 南亚科技公布十月营收[R01、R12、RN]

11 月 4 日
周三

- 高通发布四季度财报
- Arm 公布授权与版税业绩
- 格芯披露三季度收入 18.99 亿美元
- SEMI 公布硅晶圆出货
- TrendForce 更新 DRAM 市场周报[R03—R05、A21、R22]

11 月 5 日
周四

- SOX 单日下跌 12.25%
- 华虹披露三季度营收和产能利用率
- SUSS 披露季度设备订单[R14、R15、R35、R39]

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

11 月 6 日 **周五**	▪ SOX 单日回升 4.21% ▪ 科创 50 当周收涨 7.96% ▪ 华邦电子公布十月营收 ▪ 台积电举行日本设计合作研讨会 ▪ 美国 10 年期国债收益率为 4.86%[R14、R16、R17、RW、BD45]
11 月 7 日 **周六**	▪ 拓荆科技披露上交所受理资产重组申请 ▪ 精智达披露筹划 H 股发行 ▪ 据 Tom's Hardware 报道，台积电否认应英伟达要求探索 3D DRAM 生产[BD23、BD29、R30]
11 月 8 日 **周日**	▪ ICCAD 进入五日会期 ▪ IWN 氮化物半导体研讨会在熊本进入会期 ▪ 据飞象网报道，三星在进博会展出低功耗存储器和新一代通用闪存[R27、R56、R57]

本周图表

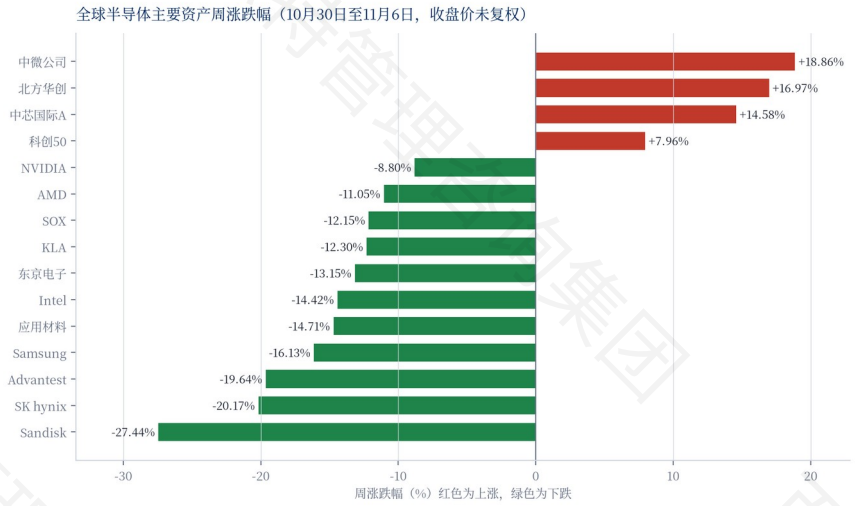


图 1　主要半导体证券周涨跌幅。比较 10 月 30 日与 11 月 6 日收盘，单位为百分比。来源见第四章。

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

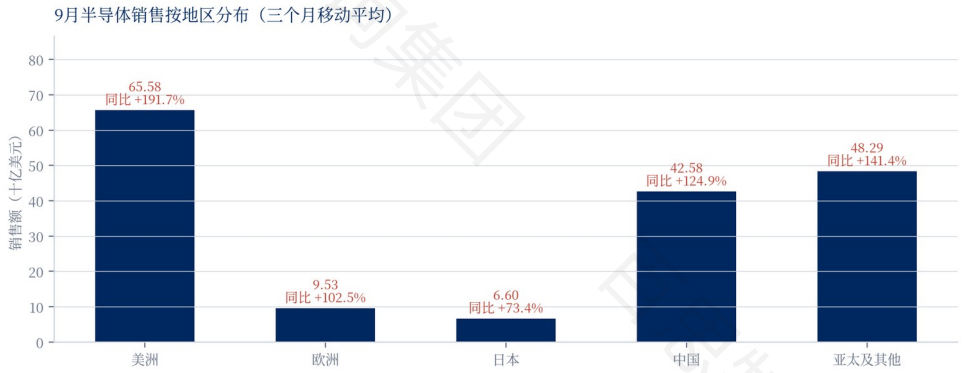


图 2　9 月全球半导体销售地区分布。单位为十亿美元，采用 WSTS 三个月移动平均。资料为 SIA 月度统计。[R12、R13]

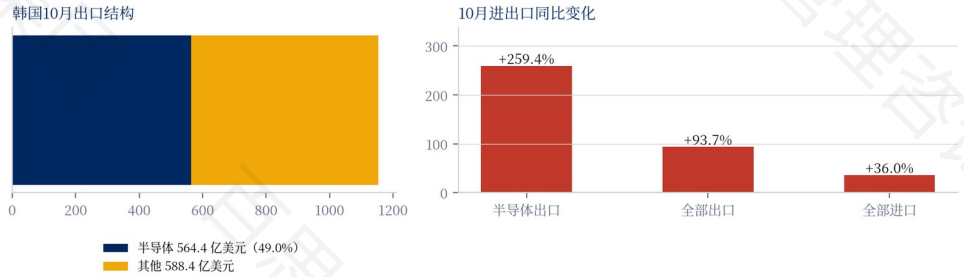


图 3　韩国 10 月出口结构及同比增速。金额单位为亿美元，增速以百分比列示。资料为 11 月 1 日月报。[RK]

本报告基于公开信息编制，仅供研究参考，不构成投资建议。

一、本周要点

服务器计算、光互连与电源器件的订单和交易各有兑现时点。

- **AMD 数据中心收入约占集团 64%。** 11 月 3 日披露的三季度数据中心收入为 85.46 亿美元，同比增加 97.0%。四季度集团指引中值 170 亿美元，约比本季增长 27%。11 月 18 日英伟达财报可补充交付观察。[R01、R02、R20]
- **光互连供应范围扩大。** Marvell 与 Lumentum 于 11 月 2 日公布换股协议。标的隐含企业价值 1,150 亿美元，每股隐含溢价 23.9%。预计 2028 年上半年完成，后续看客户资格与审批进展。[R08、R09]
- **稳压器进入芯片封装的采购计划。** onsemi 同日签约收购 Ferric，基础对价 6 亿美元，另有最高 1.75 亿美元或有付款。公司 2030 年 AI 数据中心收入目标上调 5 亿美元至超过 30 亿美元。[R10]
- **Arm 授权及其他收入增长 50.0%。** 11 月 4 日公布的数字为 7.73 亿美元，版税 6.70 亿美元。公司预计 2027 财年第四季度交付首批商业 AGI CPU。[R04]
- **汽车芯片和手机芯片走势不同。** 高通 11 月 4 日披露 QCT 汽车收入 19.90 亿美元，同比增长 89.0%。集团法定收入同比下降 8.0%。后续比较非手机业务扩张与集团收入。[R03]
- **代工扩产按项目推进。** 格芯 11 月 4 日发布三季度收入 18.99 亿美元，非 IFRS 毛利率 31.4%。其重述的中介层计划预计 2028 年上半年开始增加量产。[R05]
- **普通 DRAM 现货回落。** 11 月 6 日 16Gb DDR5 报 60.167 美元每颗，周跌 2.17%。16Gb DDR4 报 80.815 美元每颗，周跌 2.39%。按具体型号观察下一批采购。[R21]
- **股票市场分化。** 11 月 6 日 SOX 收于 9,390.25 点，周跌 12.15%。科创 50 收于 1,253.19 点，周涨 7.96% 11 月 10 日至 13 日的制造与设备数据可补充业绩依据。[R14、R16、R18、R19]
- **10 年期美债收益率周降 8 bp。** 11 月 6 日为 4.86%。厂房与设备资金成本还受实际融资期限、抵押和利差影响。[R17]

二、重大事件及其影响

从 11 月 2 日至 6 日，9 项公司与市场变化分别影响采购、融资和交付。

事件	环节	对产业的影响	来源与可信度
11 月 2 日 Marvell 与 Lumentum 签约，标的隐含企业价值 1,150 亿美元	光互连	扩大激光器、光模块与交换芯片的联合供货范围，预计 2028 年上半年交割	公司公告，高 [R08]
11 月 2 日 onsemi 拟收购 Ferric，基础现金对价 6 亿美元	供电	处理器和封装厂商可同步评估集成稳压器，后续付款与收入条件关联	公司公告，高 [R10]
11 月 2 日 Synaptics 交易条款调整，约 5 7 亿美元现金	芯片设计	固定现金对价改变交割融资安排与股东对价构成	交易文件，高 [R11]
11 月 3 日 AMD 三季度收入 133.77 亿美元，数据中心同比+97.0%	计算	机架系统供货需与服务器 CPU、加速器及配套器件交付协调	公司公告，高 [R01]
11 月 4 日 Arm 授权及其他收入 7.73 亿美元，同比+50.0%	IP	当期授权与客户芯片出货后的版税应分别观察	公司公告，高 [R04]
11 月 4 日高通 QCT 汽车芯片收入同比+89.0%	汽车	改变终端芯片收入构成，集团利润仍受手机销量影响	公司公告，高 [R03]
11 月 4 日格芯非 IFRS 毛利率 31.4%	代工	通信和数据中心产品需求影响工厂产品组合	公司公告，高 [R05]
11 月 6 日 DDR5 16Gb 现货 60.167 美元每颗	存储	短交期采购成本周降 2.17%，按型号与付款条件比较	研究原文，中高 [R21]
11 月 6 日科创 50 周涨 7.96%，SOX 周跌 12.15%	资本市场	两地企业盈利与融资成本需分别评估	指数资料，高 [R14、R16]

三、行业景气与资本市场

SIA 于 11 月 3 日公布 9 月全球芯片销售 1,725.8 亿美元，环比增长 7.9%。

SIA 将 8 月同口径月值修正为 1,599.9 亿美元。9 月名义销售额同比增长 146.8%。该数据是 WSTS 三个月移动平均。需求评估需配合客户出货、成交单价与产品结构。[R12、R13]

指标	最新值	比较	日期与来源
全球芯片销售	1,725.8 亿美元	月+7.9%、年+146.8%	9 月，11 月 3 日公布[R12、R13]
全球芯片销售	5,177 亿美元	季+24.1%	第三季度，11 月 3 日公布[R12]
韩国半导体出口	564.4 亿美元	年+259.4%	10 月，11 月 1 日公布[RK]
南亚科技月营收	464.76 亿新台币	月+3.07%、年+487.7%	10 月，11 月 3 日公布[RN]
华邦电子月营收	293.61 亿新台币	月+3.94%、年+257.0%	10 月，11 月 6 日公布[RW]
美国 10 年期国债收益率	4.86%	周−8 bp	11 月 6 日[R17]

SOX 在 11 月 5 日下跌 12.25%，11 月 6 日回升 4.21%。11 月 6 日收盘较 10 月 30 日低 12.15%。台积电台股周跌 9.92%，SK hynix 韩股周跌 20.17%。同期科创 50 周涨 7.96%。指数与个股均按上市地收盘计算。[R14、R16、MA33、MA34]

代表指数或证券	10 月 30 日	11 月 6 日	周涨跌	来源
费城半导体指数（点）	10,688.80	9,390.25	−12.15%	[MA01]
科创 50（点）	1,160.84	1,253.19	+7.96%	[MA09]
AMD（美元）	504.80	449.04	−11.05%	[MA14]
美光（美元）	884.74	690.00	−22.01%	[MA15]
KLA（美元）	157.91	138.49	−12.30%	[MA21]
三星电子（韩元）	225,000	188,700	−16.13%	[MA32]
北方华创（人民币元）	478.74	560.00	+16.97%	[MA44]

四、存储周期与装备制造链

两类 16Gb DRAM 现货周价回落，设备项目需求仍按实际投产时间发生。

11 月 6 日，TrendForce 的 16Gb DDR5 现货报价为 60.167 美元每颗。16Gb DDR4 为 80.815 美元每颗。10 月 30 日的同规格报价分别为 61.500 与 82.796 美元每颗。上述报价可用于比较急单补货成本。[R21]

11 月 4 日，TrendForce 把 HBM4 的产量增加与普通 DRAM 现货分开讨论。HBM 采购通常包含型号、交付期、测试与保留产能。固定规格的普通存储器报价会随渠道供需变化。采购分析应分别建立合同价、现货价、交付量和终端库存记录。[R21、R22]

TrendForce 11 月 4 日披露，11 月 2 日当周 512Gb TLC NAND 晶圆现货均价为 16.152 美元，较前周下跌 4.33%。10 月 30 日发布的四季度研究显示企业级 SSD 合约价格延续上涨。两组数据对应不同产品与采购期限。[R51、R53]

格芯 11 月 4 日季报重述纽约首座 300 毫米厂约 100 亿美元投资。新增产能预计 2029 年启用。其台积电制造协议预计 2028 年上半年开始增加硅中介层量产。设备采购可按工具进厂和产线验收分别安排。[R05、R34]

SUSS 于 11 月 5 日披露季度订单 2.235 亿欧元。9 月 30 日的在手订单为 6.006 亿欧元。公司表示其中大部分拟于 2027 至 2028 财年交付。设备商应区分新签订单、未交付余额和已验收收入。[R39]

五、政策、贸易与供应链安全

芯片设计和制造支持计划的作用时点由项目准入、资金安排和建设进度决定。

11 月 4 日，欧洲推出芯片设计平台，公布的投资规模为 5.25 亿欧元。平台支持设计工具与原型开发。初创公司仍需分别核算原型验证、首次流片和量产采购成本。[R40]

11 月 6 日，印度项目开放设备材料、制造及封装等申请。该计划已批准财政规模为 12,750 亿卢比。项目是否获得支持仍取决于申请和资格条件。设备厂商可按客户建设里程碑安排服务和备件。[R41]

涉及进口原料、长期制造协议与股权交易时，企业可按合同逐项保存原产地、客户承诺及交付文件。以设备验收和客户付款衡量投资执行。11 月 4 日格芯季报披露的新厂与中介层协议具有不同的供货周期。[R05]

六、重点企业动态

计算、光器件、电源与特殊工艺企业的经营指标各有比较口径。

企业	本周公布内容	后续经营观察	来源
AMD	三季度营收 133.77 亿美元。数据中心同比增长 97.0%	四季度收入与 164.9 亿至 175.1 亿美元指引比较	[R01、R02]
Marvell 与 Lumentum	11 月 2 日公布全股票协议，换股比例 4.500	客户合同、长期认证和交割进度	[R08、R09]
Arm	季度营收 14.43 亿美元，授权及其他收入 7.73 亿美元	芯片出货、版税和自有处理器交付	[R04]
高通	季度法定收入 103.22 亿美元，QCT 汽车收入为 19.90 亿美元	下一财季收入指引中值 108 亿美元	[R03]
格芯	季度营收 18.99 亿美元，法定毛利率 30.1%	按客户和项目分列工厂投入	[R05]
onsemi	披露季度业绩，签约收购 Ferric	电源器件收入与封装客户导入	[R07、R10]
华虹半导体	并表后季度营收 9.87133 亿美元，利用率 102.9%	比较并表与原业务口径，观察下季毛利率	[R35]
华邦电子	季度收入 823.31 亿新台币，毛利率 70.6%	存储收入与出货结构及工艺升级	[R36]

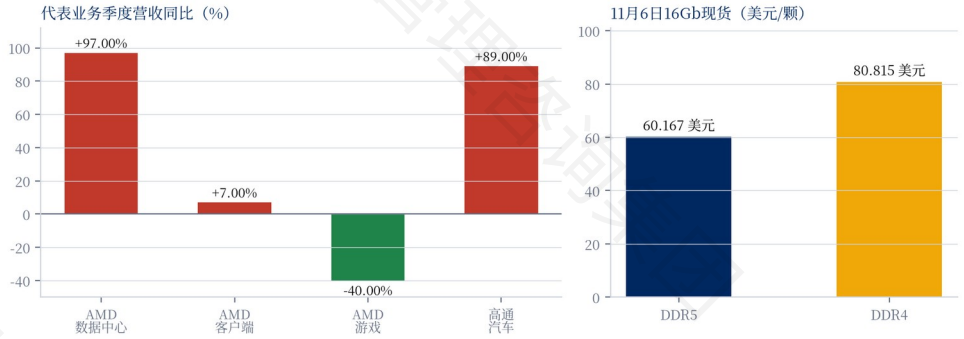


图 4　代表性公司收入变化与指定规格 DRAM 现货。分部收入同比为财报口径，现货为 11 月 6 日美元每颗报价。[R01、R03、R21]

七、中国半导体产业链

华虹半导体第三季度并表营收同比增长 19.9%，产能利用率较前季低 1.2 个百分点。

华虹半导体 11 月 5 日公布三季度并表营收 9.87133 亿美元，毛利率 24.6%。12 英寸晶圆约占收入 70.7%。公司给出下季营收 10.8 亿至 10.9 亿美元及毛利率 25%至 26%的指引。剔除华力微后的收入为 8.034 亿美元。[R35]

11 月 5 日，日月光高阶封测投资项目获批，计划规模 1,237 亿新台币。圆益石英拟投资 23.4 亿新台币扩充前道耗材能力。相关金额对应投资计划，按建设进度分期观察。[BD66]

长鑫科技 11 月 4 日披露将回购金额提议提高至 25 亿至 50 亿元。此前公布的区间为 10 亿至 20 亿元。文件所述为提议金额。实际回购金额应以生效方案和成交披露核对。[R43]

摩尔线程公布对 Kimi K3.1 Pro 图文推理的适配。公司披露模型总参数为 3 万亿。客户仍需按指定硬件核对吞吐、显存占用和服务稳定性。该案例给出了国产加速器适配的具体对象。[R44]

八、行业会议与人物观点

11 月的设计、设备及资本投资会议提供不同的产业观察口径。

ICCAD 于 11 月 8 日开幕，会期至 12 日。议程覆盖从器件物理到系统架构的电子设计自动化问题。对公开技术成果，可按工艺节点、测试样本和测试设置对比。会议报告中的原型结果应按实际披露条件解读[R27]

SEMICON Europa 安排于 11 月 10 日至 13 日举行。设备和材料企业可关注先进封装、制造自动化与供应商开发。SEMI 国际贸易伙伴会议会期为 11 月 1 日至 4 日。后续项目规模与具体交付时间以企业文件为依据。[R28、R29]

AMD 首席执行官苏姿丰在 11 月 3 日财报材料中表示，数据中心业务驱动营收超过此前指引高端。公司四季度集团指引中值为 170 亿美元。Arm 在 11 月 4 日的股东材料中称首批商业 AGI CPU 交付安排在 2027 财年第四季度。两家公司的观察指标分别为整机交付及处理器出货。[R01、R04]

九、趋势判断

计算收入增量能否维持，取决于客户批量部署、采购安排与设备交付。

趋势判断	数字依据	观察期间	反向情形
服务器计算仍有季度增长条件	AMD 次季收入指引中值 170 亿美元，较本季约+27.0%[R01]	2026 年四季度	AMD 集团收入低于 164.9 亿美元，或数据中心环比下降

趋势判断	数字依据	观察期间	反向情形
光互连联合供货范围扩大	Marvell 和 Lumentum 换股比例 4.500，预计 2028 年上半年交割[R08]	2027 年至交割	交易取消，或交割推迟两个季度
处理器供电与封装协同增加	Ferric 基础现金对价 6 亿美元，另有最高 1.75 亿美元或有付款[R10]	2027 年至 2030 年	关键产品交付推迟两个季度
终端与服务器收入继续分开变化	AMD 游戏收入−40.0%、数据中心+97.0%[R01]	两个财季	游戏恢复增长且数据中心增速低于 20%
普通 DRAM 现货波动影响短单	16Gb DDR5 与 DDR4 现货分别较前周下跌 2.17%、2.39%[R21]	四季度	同规格合约与现货连续两个月同向且价差收窄
特殊工艺按项目增加供给	格芯预计 2028 年上半年开始扩大中介层量产，首座新厂预计 2029 年投用[R05]	2027 年至 2029 年	任一项目实际延后两个季度
市场风险预算仍受单日波动约束	SOX 11 月 5 日−12.25%，11 月 6 日+4.21%[R14、R15]	未来 4 周	周内振幅降至 5%以内并伴随盈利改善

十、主要风险与下周关注事项

11 月 10 日至 13 日的晶圆代工营收、设备财报和行业会议将补充本期观察。

风险	已知依据	关注内容
机架交付延期	AMD 四季度集团指引 170 亿美元，上下 3%[R01]	收入与 164.9 亿美元下限比较，核对客户验收
光互连交割推迟	Marvell 与 Lumentum 预计 2028 年上半年完成[R08、R09]	两方审批、产品供货和交割条件
存储成本变化	16Gb DDR4 现货 80.815 美元每颗[R21]	按相同颗粒比较现货、库存与合同
资金成本变化	11 月 6 日 10 年期美债收益率 4.86%[R17]	项目实际融资利差和客户预付款

日期	事项	关注内容	需要修正判断的情形
11 月 9 日 16:00	台湾 10 月贸易统计	电子零组件与资通产品出口[R32]	相关增速低于前月 20 个百分点
11 月 10 日 13:30	台积电 10 月营收	晶圆销售与季度指引[R18]	月营收下降 10%以上

日期	事项	关注内容	需要修正判断的情形
11 月 10 日至 13 日	SEMICON Europa	项目和设备交付安排[R28]	大型项目确认推迟两个季度
11 月 13 日 05:30	应用材料财报交流	设备、服务与客户资本开支[R19]	次季指引低于本季 10%以上
11 月 18 日 06:00	英伟达财报交流	加速器、计算和网络业务[R20]	数据中心营收环比下降

十一、管理观察与行动建议

采购、产能和融资计划应使用与各自业务节点对应的指标。

芯片设计与系统企业。 AMD 次季营收指引中值 170 亿美元。设计和系统企业可按样机、小批量与批量交付设置验收指标。将主要供货方的指定型号、版本、交期与现场测试记录放入同一采购台账。[R01]

制造、存储及封测企业。 格芯中介层量产扩张安排在 2028 年上半年。制造企业可将实际订单、客户预测与产能承诺分别登记。存储企业应核对相同型号的现货报价和合同履约记录。[R05、R21]

设备材料企业。 SUSS 9 月末在手订单为 6.006 亿欧元。设备企业可跟踪工具进厂、安装和验收的时间差。材料采购量应对应实际加工晶圆量及客户认证进度。[R39]

中国产业链企业。 华虹并表后利用率 102.9%，环比下降 1.2 个百分点。产业链企业可同时核对产能口径、产品组合、订单交期与现金回收。[R35]

政策研究者。 欧洲芯片设计平台规模 5.25 亿欧元。研究记录可区分资金承诺、企业申请、项目批准、首次流片与量产等时点。使用不同币种的项目应逐项保留原币。[R40]

上市公司与资本市场研究者。 SOX 周跌 12.15%，科创 50 周涨 7.96%。估值情景可分别调整公司订单、融资成本与交付时点。换股交易采用标的企业价值、每股对价和收购方股价三项口径。[R08、R14、R16]

数据来源与口径

行情比较 10 月 30 日与 11 月 6 日当地交易收盘，财报按各公司财年列示。

本期期次为 2026 年 11 月 8 日，覆盖 11 月 2 日至 8 日。截稿为北京时间 2026 年 11 月 9 日 09:15。行情按证券原计价币种列示。涨跌幅采用两端收盘价之比减一，不含分红与汇率。韩国 10 月出口为 11 月 1 日公布的月度比较资料。

SIA 月度销售采用 WSTS 三个月移动平均。法定财报与经调整指标分列。存储价格使用指定规格现货，不将不同容量或合同交付期直接比较。企业价值包括交易公告所列债务等项目。[R03、R08、R12、R13、R21]

R01 AMD 三季度业绩与指引 [S]

R20 英伟达财报日程 [S]

R08 Marvell 与 Lumentum 合并公告 [S]

R09 Marvell 合并协议 8-K [S]

R10 onsemi 与 Ferric 交易公告 [S]

R03 高通 2026 财年四季度公告 [S]

R14 Nasdaq 费城半导体指数 [S]

R16 上交所 11 月 2 日至 6 日周报 [S]

R17 10 年期国债恒定期限收益率 [S]

R18 台积电营收与财报日程 [S]

R19 应用材料公司财报日程 [S]

RK 韩国 10 月出口统计 [S]

R15 Investing.com 费城半导体指数逐日数据 [B]

R02 AMD 三季度 Form 10-Q [S]

R06 Tower 三季度业绩与指引 [S]

R07 onsemi 三季度业绩 [S]

R11 Synaptics 交易修订公告 [S]

R12 SIA 全球销售统计 [A]

RN 南亚科技 10 月营收 [S]

R04 Arm 2027 财年第二季度公告 [S]

R05 格芯 2026 年第三季度公告 [S]

A21 SEMI 全球硅晶圆三季度出货公告 [A]

R22 TrendForce 11 月 4 日 DRAM 周度观察 [A]

R35 华虹半导体三季度公告 [S]

R39 SUSS 2026 年前九个月业绩 [S]

RW 华邦电子月度营收 [S]

BD45 台积电 [S]

BD23 拓荆科技 [S]

BD29 精智达 [S]

R30 Tom's Hardware 台积电 3D DRAM 报道 [B]

R27 ICCAD 2026 会议日程 [S]

R56 IWN 2026 主办方会期 [S]

R57 飞象网 11 月 8 日进博会三星报道 [B]

R13 SIA 与 WSTS 九月地区明细 [A]

R21 TrendForce DRAM 现货行情 [A]

MA33 SK hynix 韩股双端行情 [B]

MA34 台积电台股双端行情 [B]

MA01 费城半导体指数（SOX）双端行情 [S]

MA09 科创 50 历史行情 [S]

MA14 AMD 双端行情 [B]

MA15 Micron 双端行情 [B]

MA21 KLA 双端行情 [B]

MA32 Samsung 双端行情 [B]

MA44 北方华创双端行情 [B]

R51 TrendForce 四季度企业级 SSD 合约价 [A]

R53 TrendForce 11 月 2 日当周 NAND 晶圆报价 [A]

R34 格芯 10 月纽约项目公告 [S]

R40 欧洲芯片设计平台 [S]

R41 印度半导体 2.0 申请安排 [S]

R36 华邦电子三季度公告 [S]

BD66 台湾经济主管部门 [S]

R43 长鑫科技回购金额提议 [S]

R44 摩尔线程 Kimi K3.1 Pro 适配 [S]

R28 SEMICON Europa 会期 [S]

R29 SEMI 11 月会议日程 [A]

R32 台湾 10 月贸易统计发布日程 [S]

本报告由百思特变革研究院半导体智库基于公开信息编制，数据截至北京时间 2026 年 11 月 9 日 09:15。报告内容仅供行业研究参考，不构成任何投资建议，不代表任何政府机构或监管部门的立场；所涉政策信息均来自公开发布的法规、公告与新闻报道；引用请注明出处。